



# 平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年7月29日

上場取引所 東

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役 専務執行役員 (氏名) 堀 哲朗

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 平成28年8月10日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年6月30日)

### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	147,976	△5.0	22,095	△27.0	24,083	△20.3	12,684	△34.9
28年3月期第1四半期	155,762	2.9	30,279	77.4	30,207	78.6	19,481	64.6

(注)包括利益 29年3月期第1四半期 2,791百万円 (△87.1%) 28年3月期第1四半期 21,616百万円 (76.6%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年3月期第1四半期	77.33	77.16
28年3月期第1四半期	109.53	109.22

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年3月期第1四半期	754,695	549,795	72.5
28年3月期	793,367	564,239	70.9

(参考)自己資本 29年3月期第1四半期 546,810百万円 28年3月期 562,369百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年3月期	—	125.00	—	112.00	237.00
29年3月期	—	—	—	—	—
29年3月期(予想)	—	89.00	—	171.00	260.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 平成29年 3月期の連結業績予想(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	330,000	△3.2	49,000	△20.0	49,000	△21.5	29,000	△29.9	176.79
通期	714,000	7.5	124,000	6.2	124,000	3.9	85,000	9.1	518.17

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有  
詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示  
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有  
② ①以外の会計方針の変更 : 無  
③ 会計上の見積りの変更 : 無  
④ 修正再表示 : 無  
詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	29年3月期1Q	165,210,911 株	28年3月期	165,210,911 株
② 期末自己株式数	29年3月期1Q	1,171,263 株	28年3月期	1,176,800 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	29年3月期1Q	164,038,149 株	28年3月期1Q	177,865,767 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、平成28年7月29日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

## 【添付資料】

## [目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	9
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	11
(四半期連結損益計算書関係)	11
(セグメント情報等)	11

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間の世界経済は、総じて緩やかな回復基調が続いていますが、中国の景気減速や英国のEU離脱問題等の影響から先行きに不透明感が生じています。

エレクトロニクス産業におきましては、高機能スマートフォンに生産調整が入るなど電子機器市場に伸び悩みが見られたものの、ロジック系半導体メーカーの先端技術への投資意欲は強く、当社グループの参画しております半導体製造装置市場は総じて堅調に推移しております。

このような状況のもと、当社グループの当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高1,479億7千6百万円(前年同期比5.0%減)、営業利益220億9千5百万円(前年同期比27.0%減)、経常利益240億8千3百万円(前年同期比20.3%減)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は126億8千4百万円(前年同期比34.9%減)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

## ① 半導体製造装置

ロジック系半導体メーカーによる先端技術への投資や、3次元構造のNANDフラッシュメモリー向けの投資が堅調に推移しており、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1,307億9千6百万円(前年同期比6.8%減)となりました。

## ② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

モバイル端末用の中小型液晶パネル向け設備投資に加え、大型液晶パネル向け設備投資が中国を中心に続いており、FPD製造装置市場は好調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、170億6千4百万円(前年同期比69.4%増)となりました。

## ③ その他

当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1億1千5百万円(前年同期比97.8%減)となりました。

(ご参考)

## 【連結業績】

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
売上高	663,948	155,762	185,189	158,771	164,225	147,976
半導体製造装置	613,032	140,365	176,622	146,523	149,520	130,796
日本	116,272	25,011	37,809	27,028	26,423	17,819
米国	103,460	30,776	29,491	23,428	19,765	17,022
欧州	51,088	17,053	9,620	14,856	9,557	5,234
韓国	99,574	28,140	25,211	15,257	30,965	19,805
台湾	161,930	23,130	52,928	43,354	42,517	30,504
中国	63,605	14,084	17,041	17,219	15,260	30,049
東南アジア他	17,099	2,169	4,520	5,379	5,030	10,360
F P D製造装置	44,687	10,070	8,205	11,724	14,686	17,064
その他	6,228	5,326	361	522	18	115
営業利益	116,788	30,279	30,970	25,513	30,025	22,095
経常利益	119,399	30,207	32,177	25,655	31,359	24,083
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	77,891	19,481	21,895	17,858	18,656	12,684

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

## 【生産及び受注の実績】

## 1. 生産実績

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	592,230	147,830	150,176	131,554	162,669	140,236
F P D製造装置	50,944	10,435	12,758	10,295	17,455	9,623
その他	5,124	5,124	-	-	-	-
合計	648,299	163,390	162,935	141,849	180,124	149,860

(注) 1. 金額は販売価格によっております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	626,275	156,663	122,499	159,307	187,804	197,470
F P D製造装置	50,503	11,847	12,502	13,947	12,206	15,955
その他	2,541	1,835	204	492	9	111
合計	679,320	170,346	135,206	173,747	200,020	213,538

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 3. 受注実績 (受注残高)

(単位：百万円)

	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	当期第1Q
半導体製造装置	276,766	222,643	235,426	273,710	340,384
F P D製造装置	33,388	37,686	39,908	37,428	36,319
その他	201	44	13	4	1
合計	310,355	260,373	275,348	311,143	376,704

- (注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 財政状態に関する説明

## ① 財政状態

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ310億3千7百万円減少し、5,863億7千8百万円となりました。主な内容は未収消費税等の減少222億4百万円、受取手形及び売掛金の減少137億5千6百万円、有価証券に含まれる短期投資の減少134億9千9百万円、たな卸資産の増加84億1百万円、現金及び預金の増加77億6千8百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から15億7千5百万円減少し、947億4千1百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から18億8千4百万円減少し、157億1千8百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から41億7千5百万円減少し、578億5千6百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から386億7千2百万円減少し、7,546億9千5百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ227億4千6百万円減少し、1,433億1千4百万円となりました。主として、未払法人税等の減少145億2千3百万円、賞与引当金の減少72億7千6百万円、支払手形及び買掛金の減少35億9百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ14億8千1百万円減少し、615億8千6百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ144億4千3百万円減少し、5,497億9千5百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益126億8千4百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当183億7千1百万円の実施による減少、その他の包括利益累計額98億8千6百万円の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は72.5%となりました。

## ② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ192億7千1百万円増加し、1,149億1千万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,160億3千2百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ57億3千万円減少し、2,309億4千3百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ47億9千9百万円増加の221億9千3百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益161億9千1百万円、減価償却費39億9千4百万円、未収消費税等の減少221億4千万円、売上債権の減少106億3千6百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額194億1千4百万円、たな卸資産の増加124億8千8百万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出になったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として短期投資の減少による収入249億9千8百万円、有形固定資産の取得による支出47億6千2百万円により、前年同期の320億2千8百万円の支出に対し200億6千3百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払による支出183億7千1百万円により、前年同期の363億6千2百万円の支出に対し183億7千5百万円の支出となりました。

## 【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第1四半期 連結累計期間	当第1四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,394	22,193
税金等調整前四半期純利益	29,099	16,191
減価償却費	4,624	3,994
売上債権の増減額(△は増加)	13,427	10,636
たな卸資産の増減額(△は増加)	△18,515	△12,488
仕入債務の増減額(△は減少)	△6,123	△1,452
その他	△5,117	5,313
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,028	20,063
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	△29,987	24,998
その他(固定資産の取得等)	△2,041	△4,934
財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,362	△18,375
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,262	△4,609
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△48,734	19,271
現金及び現金同等物の期首残高	317,632	95,638
現金及び現金同等物の四半期末残高	268,897	114,910
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	298,936	230,943

## (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年3月期の連結業績予想につきましては、前回発表時(平成28年5月12日)の見通しを変えておりません。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

(平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第 32 号 平成 28 年 6 月 17 日)を当第 1 四半期連結会計期間に適用し、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	75,674	83,443
受取手形及び売掛金	116,503	102,746
有価証券	160,999	147,500
商品及び製品	130,478	133,995
仕掛品	41,556	44,779
原材料及び貯蔵品	23,044	24,706
その他	69,207	49,265
貸倒引当金	△48	△58
流動資産合計	617,416	586,378
固定資産		
有形固定資産	96,316	94,741
無形固定資産		
その他	17,603	15,718
無形固定資産合計	17,603	15,718
投資その他の資産		
その他	63,857	59,639
貸倒引当金	△1,825	△1,782
投資その他の資産合計	62,031	57,856
固定資産合計	175,951	168,317
資産合計	793,367	754,695
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	55,050	51,540
未払法人税等	22,460	7,937
製品保証引当金	8,686	7,571
その他の引当金	13,044	4,582
その他	66,818	71,681
流動負債合計	166,060	143,314
固定負債		
その他の引当金	374	374
退職給付に係る負債	55,302	55,506
その他	7,390	5,704
固定負債合計	63,067	61,586
負債合計	229,128	204,900

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	427,618	421,907
自己株式	△8,050	△8,012
株主資本合計	552,551	546,879
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	7,902	5,225
繰延ヘッジ損益	50	137
為替換算調整勘定	6,742	△741
退職給付に係る調整累計額	△4,877	△4,690
その他の包括利益累計額合計	9,817	△68
新株予約権	1,641	2,763
非支配株主持分	228	221
純資産合計	564,239	549,795
負債純資産合計	793,367	754,695

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

## 第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
売上高	155,762	147,976
売上原価	90,057	90,650
売上総利益	65,704	57,325
販売費及び一般管理費		
研究開発費	17,577	17,767
その他	17,848	17,461
販売費及び一般管理費合計	35,425	35,229
営業利益	30,279	22,095
営業外収益		
受取配当金	268	278
為替差益	—	1,302
その他	600	467
営業外収益合計	869	2,048
営業外費用		
閉鎖拠点維持管理費用	47	26
為替差損	810	—
その他	82	34
営業外費用合計	941	61
経常利益	30,207	24,083
特別利益		
固定資産売却益	258	23
投資有価証券売却益	—	6
特別利益合計	258	29
特別損失		
災害による損失	—	7,828
関係会社株式売却損	1,110	—
その他	255	93
特別損失合計	1,366	7,921
税金等調整前四半期純利益	29,099	16,191
法人税等	9,610	3,492
四半期純利益	19,488	12,698
非支配株主に帰属する四半期純利益	7	13
親会社株主に帰属する四半期純利益	19,481	12,684

四半期連結包括利益計算書  
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
四半期純利益	19,488	12,698
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	555	△2,673
繰延ヘッジ損益	△32	31
為替換算調整勘定	2,129	△7,447
退職給付に係る調整額	△521	181
持分法適用会社に対する持分相当額	△3	0
その他の包括利益合計	2,127	△9,906
四半期包括利益	21,616	2,791
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	21,602	2,798
非支配株主に係る四半期包括利益	14	△7

## (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結損益計算書関係)

災害による損失

平成 28 年熊本地震の影響による、建物、生産・開発設備等の原状回復及び在庫の廃棄等に係る実績及び現時点での見積費用であります。

(セグメント情報等)

## ① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

## ② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第 1 四半期連結累計期間(自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 6 月 30 日)

(単位：百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	130,796	17,064	3,288	151,149	△3,173	147,976
セグメント利益	26,720	1,197	131	28,049	△11,858	16,191

(注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、PV(太陽光パネル)製造装置事業及び当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。

2. セグメント利益の調整額△11,858 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△3,542 百万円及び、災害による損失△7,828 百万円等であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

## ③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。